

广东科翔电子科技股份有限公司 关于拟与信丰县人民政府签订项目投资合同书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次拟签订的投资合同书属于双方针对拟投资项目达成的合作意向，具体投资事项的 implementation 尚需合作双方进一步落实。合同尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过后签订，公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。

2. 合同所涉项目的实施，尚须向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可等前置审批工作，如因政策调整、项目备案等条件因素发生变化，合同的履行可能存在变更、延期、中止或终止的风险，合同中的投资金额、项目建设计划等可能存在不确定性，项目的预期收益可能受到不利影响。公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。

3. 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于本次投资仍存在不确定性，暂无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。

一、对外投资概述

1、广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于与信丰县人民政府签订项目投资合同书的议案》，公司拟与信丰县人民政府签订《关于新建高端PCB智能制造工厂项目投资合同书》（以下简称“合同书”），在江西省信丰县投资生产制造PCB产品的项目，生产经营特种板、厚铜板、金属基板、陶瓷基板等高技术含量、高附加值印制电路板产品。项目总投资约20亿元。

2. 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次拟签订的合同书，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1. 名称：信丰县人民政府
2. 住所地：江西省赣州市信丰县城东大道56号
3. 上述交易对手与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排，亦不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1. 项目名称：新建高端PCB智能制造工厂项目（具体以项目备案名称为准）。
2. 经营范围：生产经营特种板、厚铜板、金基属板、陶瓷基板等高技术含量、高附加值印制电板产品。
3. 项目投资规模：总投资20亿元（人民币）。

四、合同书的主要内容

甲方：信丰县人民政府

乙方：广东科翔电子科技股份有限公司

一、项目基本情况

（一）项目名称：新建高端PCB智能制造工厂项目。

（二）经营范围：生产经营特种板、厚铜板、金基属板、陶瓷基板等高技术含量、高附加值印制电板产品。

（三）投资方式：项目属内资项目。由乙方在项目所在地设立具有独立法人资格的有限责任公司，具体负责项目建设运营，实行自主经营、独立核算、照章纳税、自负盈亏。

（四）项目租赁县高新区绿色产业园，具体以租赁合同为准。

（五）项目投资规模：项目总投资20亿元（人民币，下同）。企业注册资本30,000万元。项目2022年完成规模以上企业统计。

二、甲方的权利和义务

(一) 租赁厂房：租赁高新区绿色产业园（深圳大道与温州路交叉口）

地理位置：高新区绿色产业园项目位于信丰高新区深圳大道与温州路交叉口，规划占地158.5亩，总建筑面积约13.4万平方米。

(二) 土地出让：甲方协调县自然资源局组织土地“招拍挂”，乙方通过“招拍挂”方式取得项目建设用地使用权。土地出让具体事项由乙方与县自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》确认。如乙方通过“招拍挂”方式未能取得相应的土地使用权，相关事宜另行协商。

(三) 乙方按照法律法规和有关行政主管部门要求递交完备的资料后，甲方应协调有关行政主管部门在乙方缴清土地价款规定时间内办结用地手续及《建设用地规划许可证》等证照。

(四) 乙方缴清土地价款后，甲方应协调有关行政主管部门先行办理《不动产权登记证》（国有建设用地使用权登记）。乙方厂房、办公楼、宿舍楼等建（构）筑物建成后，在材料齐全和法定条件具备的情况下，甲方协助乙方办理《不动产权登记证》（房屋或构筑物所有权登记）。

(五) 甲方不得干预乙方合法、正当的生产经营活动，并切实帮助乙方解决生产经营过程中的困难和问题。

(六) 在符合法律、法规以及相关政策的前提下,甲方负责厂区外通水、通电、通路等基础设施建设。其中，供电部门负责将电力线路架设到企业围墙边，供水部门负责将自来水总管接至企业围墙边。

(七) 若甲方未按照约定时间供地，则项目开（竣）工、固定资产投资、主营业务收入、纳税等指标完成时间可相应顺延。

三、乙方的权利和义务

(一) 乙方在依约履行双方约定完成项目建设的前提下，享受省、市、县关于招商引资的优惠政策，就高不就低，不重复、不叠加享受。乙方承诺本项目在信丰存续10年以上。

(二) 乙方应按县自然资源局发布的本项目意向用地《挂牌出让公告》要求交纳土地使用权竞买保证金，取得竞买资格，参与土地使用权竞价。摘牌成交后，与县自

然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，按约定缴清土地价款。

（三）在符合信丰高新技术产业园区总体规划的前提下，乙方可以自行聘请有相应设计资质的设计单位进行厂区规划设计。项目规划、建筑设计方案须经甲方审查并报相关行政主管部门批准，办理《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》后，由相关行政主管部门放线后方可施工，建筑红线一经划定，不得随意改变。

（四）乙方可以自行聘请有相应资质的施工队伍建设厂房、宿舍、办公楼等设施。

（五）乙方项目固定资产投资应达到400万元/亩以上，严格执行《工业项目建设用地控制指标》及《国有建设用地使用权出让合同》约定的本项目用地规划条件。项目竣工投产后，每亩年创税20万元以上。

（六）乙方通过“招拍挂”方式取得的工业用地，享有50年土地使用权，乙方必须将项目用地用于与本合同约定项目有关的范围，且不得违反有关强制性规定，未经甲方同意不得转让或变相转让。

（七）乙方在施工过程中，必须严格遵守有关法律、法规及政策规定，确保工程质量和施工安全，自觉接受项目所在地有关行政主管部门的监督、管理，承担因质量、安全、环保等原因所引发的一切经济 and 法律责任。

（八）乙方项目建设运营实施机构必须依法办理企业法人营业执照，守法经营，依法纳税；依法办理环评手续，严格落实安全生产和环境保护“三同时”；规范用工行为，依法保障劳动者合法权益。

（九）乙方应在项目全面投产后30日内，向甲方书面申请固定资产投资、投资强度、建筑指标等综合验收。

四、违约责任

（一）甲方的违约责任

1. 乙方足额交纳土地价款后，甲方未协调有关行政主管部门按合同约定的期限办结用地手续及相关证照的，经催告，60日内仍未办结，乙方有权解除合同，并要求甲方退还全部土地价款（不计利息）。

2. 甲方非法干预乙方合法生产经营活动，给乙方造成损失的，甲方应当赔偿乙方的实际经济损失。

（二）乙方的违约责任

1. 乙方未按约定的期限缴清土地价款，甲方有权依法收取乙方逾期违约金，或向乙方主张解除合同，会同有关行政主管部门依法收回土地使用权，且因此产生的损失全部由乙方承担。

2. 乙方未按约定的期限开工建设和竣工投产的，或未按约定的期限完成投资强度的，甲方会同有关行政主管部门依法向乙方征收土地闲置费，并有权解除合同，依法无偿收回土地使用权。乙方未按约定期限完成固定资产投资或未按约定实现年度主营业务收入、年纳税目标时，甲方有权终止，并要求乙方返还此前给予其相关优惠政策所涉全部奖补资金。

3. 乙方未征得甲方的书面同意，不得将本合同规定的权利和义务转让给第三方，乙方违约转让的，甲方可单方解除合同，要求乙方赔偿甲方由此所造成的损失并支付违约金。

五、其他事项

（一）本合同规定的乙方投资项目的固定资产投资额，由双方指定的有资质的会计师事务所或审计师事务所出具的验资报告为准，验资费用由乙方承担。

（二）若乙方设立新的公司开展此项目，本合同项下约定的权利与义务均由新公司承受。

（三）本合同系《国有建设用地使用权出让合同》组成部分，与《国有建设用地使用权出让合同》具有同等效力。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 本次投资的目的和影响

公司现有产能主要用于消费电子、5G 通讯、新能源汽车、工业控制等 PCB 产品的生产，导致应用于清洁能源、储能、工业电源等领域的厚铜板、铝基板和其他特殊板生产能力不足，无法满足下游客户对于 PCB 应用多元化和品类多元化的需求。本次投资项目实施完成后，公司的厚铜板、铝基板、和其他特殊板的生产能力将得到很大程度提升，有利于公司进一步完善 PCB 多元化产品线，从而满足下游客户的采购需求，提升公司的综合竞争力。

2. 本次投资存在的风险

本次拟签订的投资合同书属于双方针对拟投资项目达成的合作意向，具体投资事

项的实施尚需合作双方进一步落实，合同的履行可能存在不确定性风险。

合同所涉及项目的实施，尚须向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可等前置审批工作，在项目实施过程中，如因国家或地方有关政策调整、行业政策、市场环境等变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，合同中的投资金额、项目建设计划等可能存在不确定性，项目的预期收益可能受到不利影响。

公司将密切关注该投资项目的进展情况，严格按照有关法律、法规、规范性文件的有关规定，履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

六、备查文件

1. 第二届董事会第十次会议决议；
2. 第二届监事会第八次会议决议；
3. 《关于新建高端PCB智能制造工厂项目投资合同书》。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2023年9月23日